



Fully Automatic Epoxy Die Bonder

DBX-1000

New

高精度・高生産性かつ
快適な操作性を実現
LED向けフルオートダイボンダ

High speed, High accuracy
and User-friendly operation
LED Die Bonder



DBX-1000 の特長

- 高速・高精度エポキシダイボンダ
- スタンピング及びボンディングヘッドのデジタル化
- ボンディング加重のデジタル化

Features of DBX-1000

- High speed & accuracy Epoxy Die Bonder
- Epoxy, Bonding head digital programmable
- Digitalized bonding force

DBX-1000 Fully Automatic Epoxy Die Bonder

■主な仕様

ボンディングシステム	エポキシ接合
ボンディングスピード	0.18秒/サイクル(プロセス時間含まず)
ボンディング繰り返し精度	位置: ±25 μm (3σ) 角度: ±3° (3σ)
ボンディング範囲	X : 220mm Y : 92mm
ボンディング加重	30~180g
チップサイズ	□0.15~□1.5mm
リードフレームサイズ	長さ : 90~230mm 幅 : 20~100mm 厚さ : 0.1~2mm
マガジンサイズ	長さ : 95~235mm 幅 : 30~110mm 高さ : 100~175mm ストック数 : 2~3マガジン
ウエハサイズ	4インチ用グリップリング(外形φ152mm) 6インチ用グリップリング(外形φ210mm)/OP
基本OS	Windows 7 Embedded
エア	0.4Mpa (4Kgf/cm ²) 以上 (消費量: 30 ℓ /min)
電源	単相 AC200~240V 50/60Hz
消費電力	0.9KVA
外観寸法	W1750×D1080×H2050mm (警告灯含む)
重量	930kg

■SPECIFICATIONS

Bonding System	Epoxy resin
Bonding Speed	0.18sec/cycle (Dry run)
Repeatability of Bonding Accuracy	Position: ±25 μm (3σ) Angle: ±3° (3σ)
Bonding Area	X : 220mm Y : 92mm
Bonding Force	30~180g
Chip Size	□0.15~□1.5mm
Lead Frame Size	Length : 90~230mm Width : 20~100mm Thickness : 0.1~2mm
Magazine Size	Length : 95~235mm Width : 30~110mm Height : 100~175mm No. of Stock : 2~3 Magazines
Wafer Size	Grip ring for 4 inch wafer (Outer φ152mm) Grip ring for 6 inch wafer (Outer φ210mm)/OP
Operation System	Windows 7 Embedded
Air	0.4Mpa (4Kgf/cm ²) or more (Consumption: 30 ℓ /min)
Power Source	AC200~240V 50/60Hz
Power Consumption	0.9KVA
Overall Dimensions	W1750×D1080×H2050mm (Including indicating lamp)
Weight	930kg

⚠ 安全に関する注意: 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
●カタログ上の注意・・・カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ CAUTION FOR SAFE: Please read surely INSTRUCTION MANUAL before operate.
●Specification is subject to change without prior notice for improvement.

KAIJO® KAIJO CORPORATION URL: <http://www.kaijo.co.jp>

HEAD OFFICE: BONDING MACHINERY DIVISION
3-1-5, SAKAE-CHO HAMURA-SHI, TOKYO, JAPAN 205-8607 TEL 81-42-555-6162 FAX 81-42-579-5175

OVERSEAS SALES DEPARTMENT TEL 81-42-555-0321 FAX 81-42-579-5175

TAIWAN KAIJO SHIBUYA CORPORATION TEL 886-2-8712-2377 FAX 886-2-8712-3528

KAIJO SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
TEL 86-21-6275-1515 FAX 86-21-3216-0677

KAIJO (THAILAND) CO., LTD TEL 66-2-673-9496 FAX 66-2-673-9499

OVERSEAS DISTRIBUTOR